

Title (en)

Method for cooling of hot pressed boards, especially particle boards and fibreboards, and plant for carrying out the process

Title (de)

Verfahren zum Kühlen von heissverpressten Platten, insbesondere Holzspan- und Faserplatten und Anlage zur Verfahrensdurchführung

Title (fr)

Procédé pour le refroidissement de panneaux pressé à chaud, en particulier de panneaux en particules de bois et en fibres de bois, et installation pour la mise en oeuvre de ce procédé

Publication

EP 0916460 A1 19990519 (DE)

Application

EP 98119349 A 19981014

Priority

- DE 19750847 A 19971117
- DE 19821153 A 19980512

Abstract (en)

The cooling process involves a first working stage in which the hot-pressed boards are intensively cooled with water to about 100 degrees C and a second working stage in which the board surface is cooled with air to below 60 degrees C. During the first stage or between the stages, the moisture and volatile binder are extracted for at least partial reconditioning. The apparatus used has a cooling run (4) including at least a first cooling device (4a) with a second cooling device (4b) after it, and a reconditioning zone.

Abstract (de)

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Kühlen von heißverpressten Platten zu schaffen und eine Anlage zur Verfahrensdurchführung vorzuschlagen, mit dem/der eine erhebliche Verkürzung der Platten-Kühldauer erreicht wird. Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß die heißverpressten Platten in einem ersten Arbeitsschritt mittels Wasser innerhalb einer ersten Periode t1 von einer Oberflächentemperatur, die mehr als 100 °C beträgt, intensiv auf etwa 100 °C abgekühlt werden und daß in einem zweiten Arbeitsschritt die Plattenoberfläche mittels Luft innerhalb einer zweiten Periode t2 auf unter 60 °C abgekühlt wird und wobei bereits während des ersten Arbeitsschrittes oder zwischen dem ersten und dem zweiten Arbeitsschritt die Rekonditionierung der Platten eingeleitet wird. <IMAGE>

IPC 1-7

B27N 7/00

IPC 8 full level

B27N 7/00 (2006.01)

CPC (source: EP US)

B27N 7/00 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] DE 4244367 A1 19940630 - BIELE S A [ES]
- [A] GB 2232634 A 19901219 - AGRIFIBRE DEV LTD [GB]
- [A] EP 0255950 A2 19880217 - HOMANIT GMBH & CO KG [DE], et al
- [A] US 5008057 A 19910416 - RISIUS HARALD [DE], et al
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 001 28 February 1995 (1995-02-28)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 168 (M - 594) 29 May 1987 (1987-05-29)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FI FR GB IT LI LU PT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0916460 A1 19990519; JP 3081192 B2 20000828; JP H11221810 A 19990817; US 6126883 A 20001003

DOCDB simple family (application)

EP 98119349 A 19981014; JP 32668698 A 19981117; US 19167698 A 19981113